

TAS6884-Q1 具有电流检测和实时负载诊断功能的 48V、13A 数字输入 4 通道汽车级 D 类音频放大器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
 - 温度等级 1：-40°C 至 +125°C，T_A
- 常规运行
 - 4.5V 至 48V 电源电压，50V 负载突降
 - 支持 1.8V 和 3.3V I/O
 - I²C 控制，具有 8 个地址选项
 - 14.4V 时的空闲功率损耗低于 2W，最大 VBAT+PVDD 关断损耗低于 8μA
- 集成 DSP 处理
 - H 类电源电压控制
 - 热监控和折返
 - 削波探测、PVDD 监控和折返
- 使用 I²S/TDM 按通道进行输出电流检测
 - 无需外部电路
- 实时负载诊断
 - 在播放音频时监控输出状况开路负载、短路负载
 - 每个通道的实时温度监测
- 直流和交流备用负载诊断
- 音频输入
 - 2-4 通道 I²S 或 4-16 通道 TDM 输入
 - 输入采样率：44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
 - 采样速率为 96k 时，低延迟低于 100μs
- 音频输出
 - 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
 - 高达 13A 的通道输出电流
 - 400VA 峰值 BTL 输出功率
 - 136W (48V，8Ω，1% THD+N，BTL)
 - 250W (48V，4Ω，1% THD+N，BTL)
 - 418W (45V，2Ω，1% THD+N，PBTL)
- 音频性能
 - THD+N 0.03% (8Ω，1W，1kHz)
 - 111 dB 的信噪比 (SNR)
 - 37μV (14.4V)、80μV (45V) 输出噪声
- 保护
 - 输出短路保护
 - 直流失调电压，欠压和过压
 - 可配置过热警告和单个通道关断
 - I²C 温度和电源电压读数
- 可轻松满足 CISPR25L5 EMC 规范要求
 - 高级展频

2 应用

- 汽车外部放大器
- 汽车音响主机

3 说明

TAS6884-Q1 是一款四通道、数字输入、高压、D 类音频放大器，支持高达 48V 的电源电压。该器件在 155W (48V、8Ω、1% THD、BTL) 和 250W (48V、4Ω、1% THD、BTL) 下提供四个通道。

TAS6884-Q1 集成了直流和交流负载诊断功能，可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。在音频播放期间，可通过适用于每个通道的输出电流检测功能和每个通道的温度来监控状态，并通过 TDM 以超小的延迟将测量结果报告给主机处理器。

该器件在播放音频时使用独立于主机和音频输入运行的实时负载诊断功能来监控输出负载状况。为优化系统效率，TAS6884-Q1 的集成式 DSP 可实现 H 类包络跟踪控制，从而无需开发复杂的跟踪软件，也无需使用外部微控制器。

TAS6884-Q1 器件为每个通道提供一个额外的低延迟信号路径，在 48kHz 条件下提供最高快 70% 的信号处理速度，在 96kHz 采样速率下支持小于 100μs 的音频信号路径延迟，从而支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用。

TAS6884-Q1 采用带外露散热焊盘的 64 引脚 QFP 封装，TAS6884-Q1 与 TAS6684A-Q1 引脚对引脚兼容。

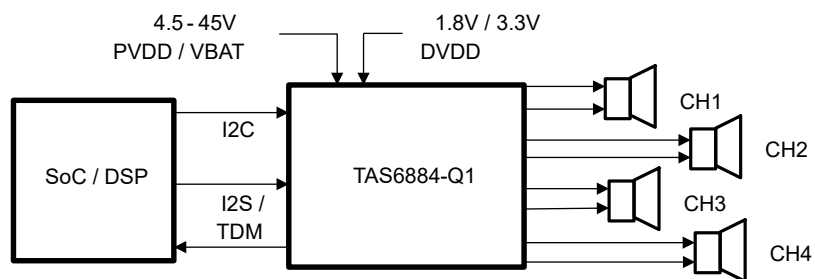
封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 (标称值) ⁽²⁾
TAS6884-Q1	PHD (HTQFP, 64)	14mm × 14mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。





简图

内容

1 特性.....	1	5.4 静电放电警告.....	4
2 应用.....	1	5.5 术语表.....	4
3 说明.....	1	6 修订历史记录.....	4
4 相关产品.....	3	7 机械、封装和可订购信息.....	4
5 器件和文档支持.....	4	7.1 封装选项附录.....	5
5.1 接收文档更新通知.....	4	7.2 卷带包装信息.....	6
5.2 支持资源.....	4	7.3 机械数据.....	8
5.3 商标.....	4		

4 相关产品

器件型号	通道数	PVDD 最大工作电压	OTSD 寄存器报告功能	PBTL 模式下的肖特基二极管数量	2 Ω 、PBTL、1% THD+N、BD 模式下的最大 POUT
TAS6684-Q1	4	45V	视具体情况而定	16	25V 时为 200W
TAS6684A-Q1	4	45V	有效	16	25V 时为 200W
TAS6682-Q1	2	45V	有效	8	25V 时为 200W
TAS6884-Q1	4	48V BTL、45V PBTL	有效	0	45V 时为 400W

5 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

5.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

5.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

5.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

5.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

5.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

6 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
August 2026	*	初始发行版

7 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

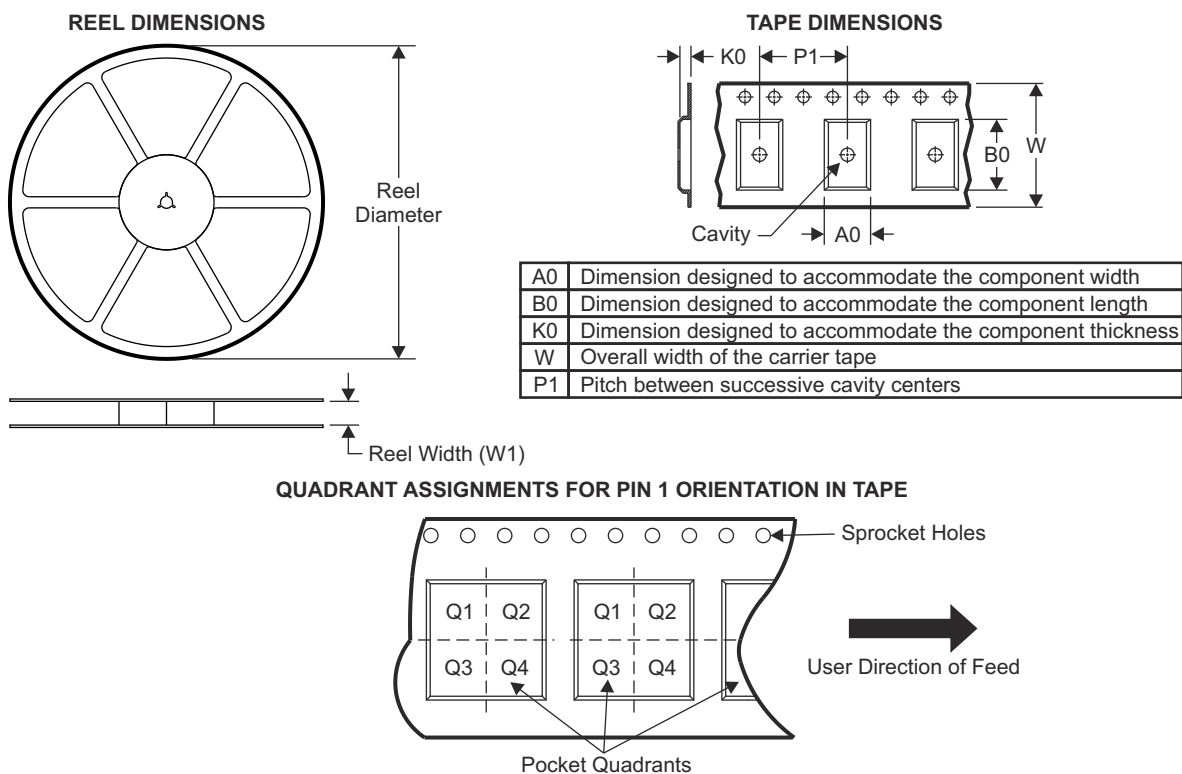
7.1 封装选项附录

封装信息

可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	铅/焊球镀层 ⁽⁶⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标识 ⁽⁴⁾ (5)
TAS6884QPHDRQ1	ACTIVE	HTQFP	PHD	64	1000	RoHS 和绿色环保	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 至 125	TAS6884

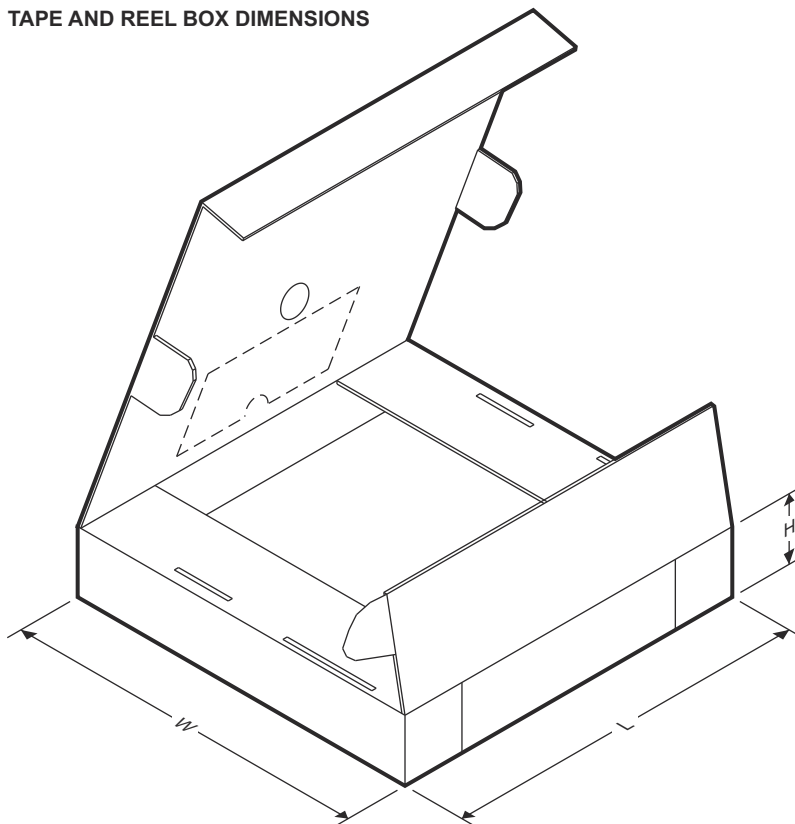
- (1) 销售状态值定义如下：
正在供货：建议用于新设计的产品器件。
限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。
NRND：不推荐用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD：器件未发布，尚未量产，未向大众市场供货，也未在网络上供应，未提供样片。
预发布：器件已发布，但未量产。可能提供样片，也可能无法提供样片。
已停产：TI 已停止生产该器件。
- (2) 环保计划 - 规划的环保分级包括：无铅 (RoHS)，无铅 (RoHS 豁免) 或绿色 (RoHS，无镉/溴) - 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情，请访问 www.ti.com.cn/productcontent。
待定：无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS)：TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求，包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅 (RoHS 豁免)：该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免：1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点；2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则，元件将根据上述规定视为无铅 (符合 RoHS)。
绿色环保 (RoHS，无镉/溴)：TI 定义的“绿色环保”表示无铅 (符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无镉 (Sb) 系阻燃剂 (均质材料中 Br 或 Sb 的质量不超过总质量的 0.1%)。
- (3) MSL，峰值温度-- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。
- (4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
- (5) 如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
- (6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽，则会折为两行。

7.2 卷带包装信息



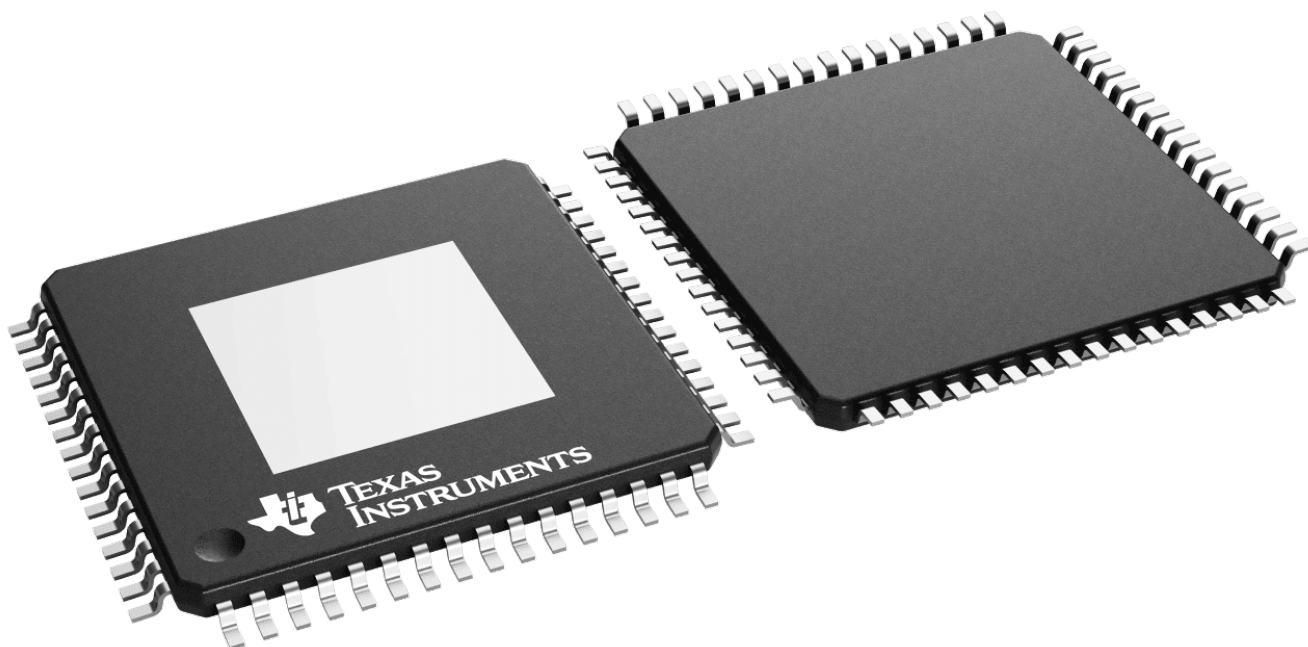
器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TAS6884QPHDRQ1	HTQFP	PHD	64	1000	330.0	24.4	17.0	17.0	1.5	20.0	24.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
TAS6884QPHDRQ1	HTQFP	PHD	64	1000	350.0	350.0	43.0

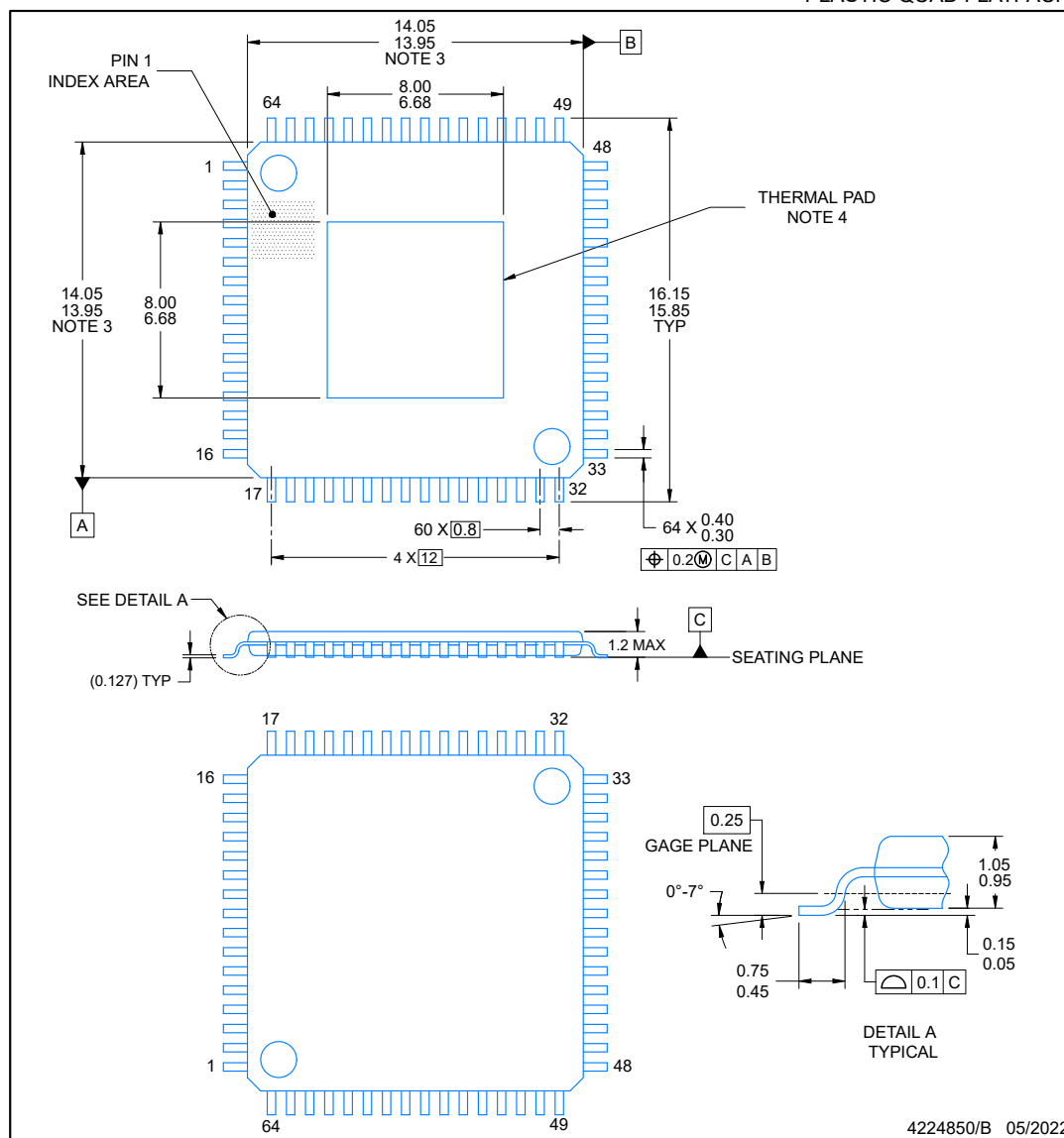
7.3 机械数据



PHD0064B

PACKAGE OUTLINE HTQFP - 1.2 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK

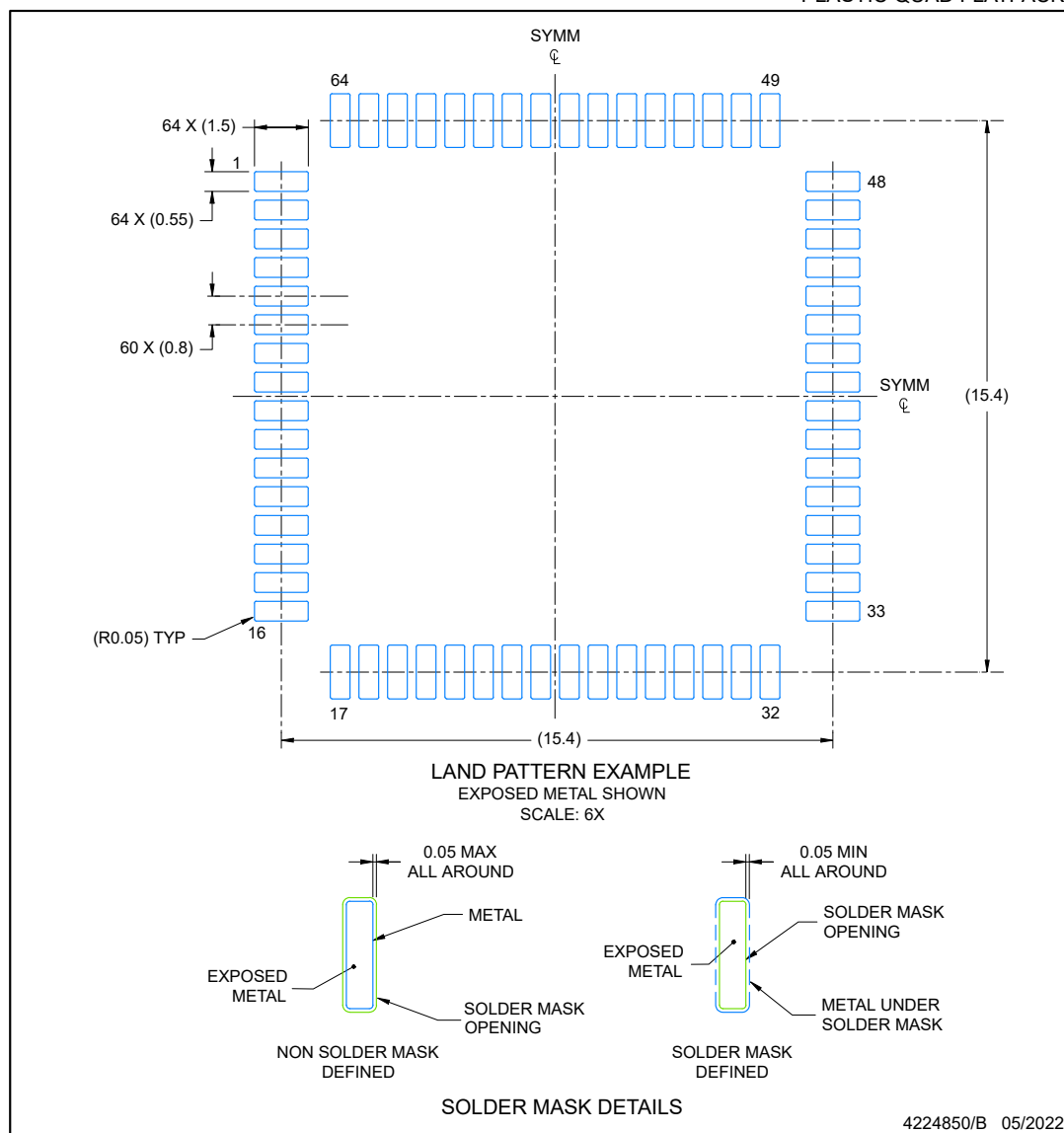


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. See technical brief, PowerPad Thermally Enhanced Package, Texas Instruments Literature No. SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004) for information regarding recommended board layout.

EXAMPLE BOARD LAYOUT**HTQFP - 1.2 mm max height****PHD0064B**

PLASTIC QUAD FLATPACK



NOTES: (continued)

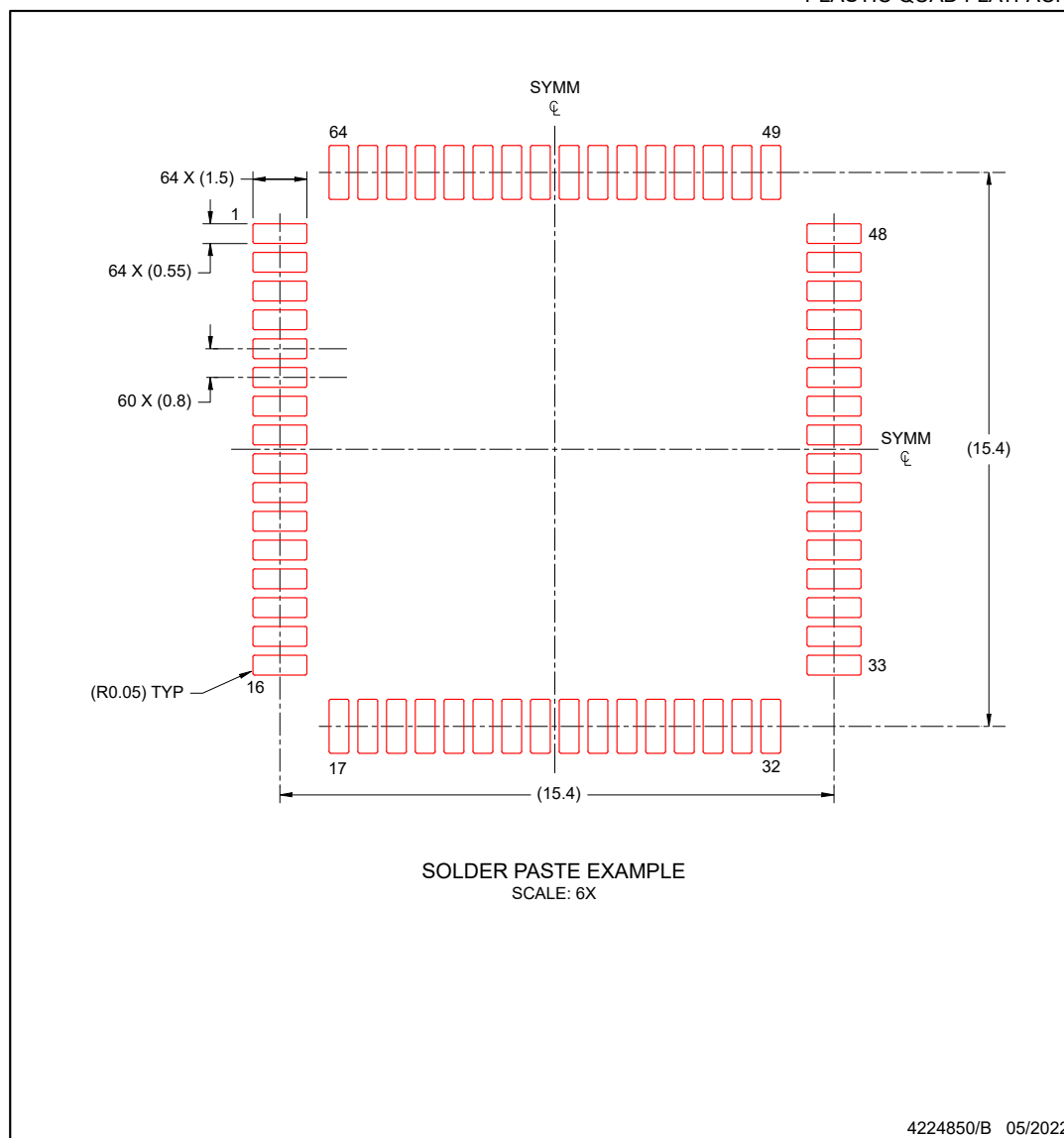
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
7. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PHD0064B

HTQFP - 1.2 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK



NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月